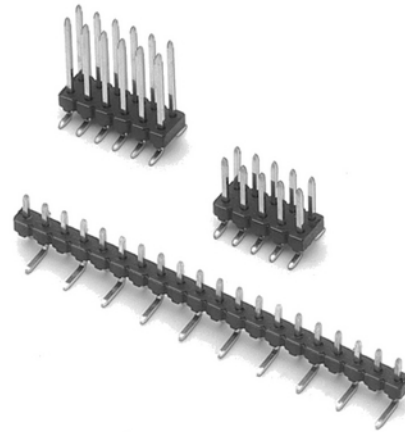


3532 3132

SMT Stiftheisen - RM 2,54mm - stehend - Präzisionskontakte SMT Pin Headers - Pitch 2,54mm - Vertical Type - Precision Contacts

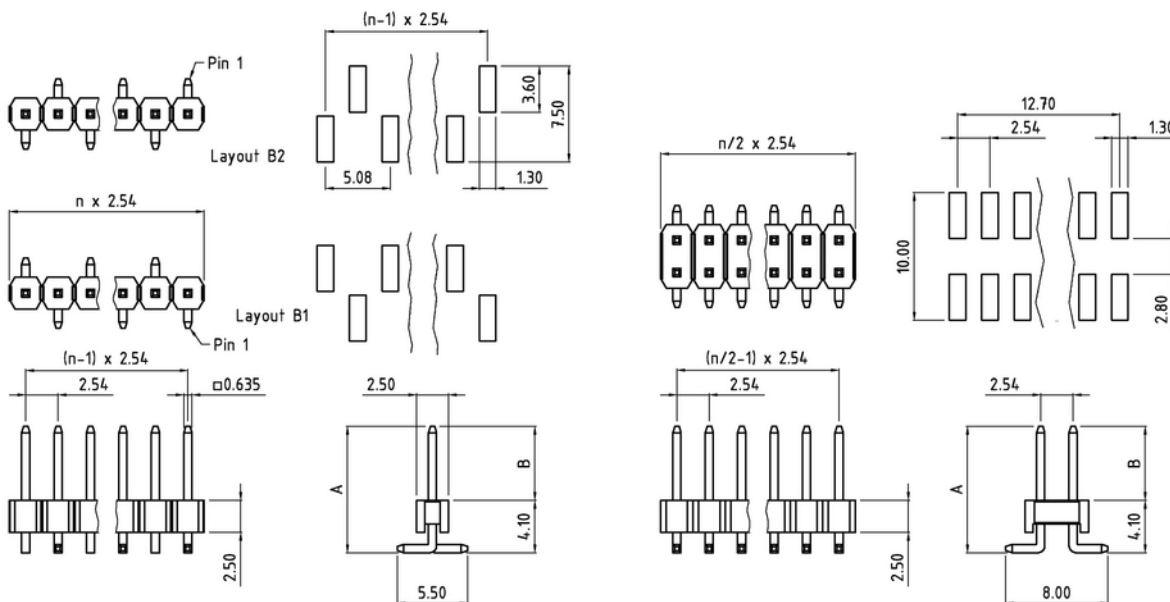
Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper	Thermoplastischer Kunststoff, nach UL94 V-0
Insulator	Thermoplastic, rated UL94 V-0
Kontaktmaterial	Vierkantstift 0,635mm, Kupferlegierung
Contact Material	Square pin 0,635mm, copper alloy
Kontaktoberfläche	Lt. Oberflächenoptionen, über Ni (1,3 ... 2,5µm)
Contact Surface	Acc. to options (see below), over Ni (1,3 ... 2,5µm)
Lötbarkeit	IEC512-12A
Solderability	IEC512-12A
Durchgangswiderstand	< 20mΩ
Contact Resistance	< 20mΩ
Isolationswiderstand	> 10 ⁹ Ω
Insulation Resistance	> 10 ⁹ Ω
Spannungsfestigkeit	1000V _{DC}
Test Voltage	1000V _{DC}
Nennspannung	250V _{AC}
Voltage Rating	250V _{AC}
Nennstrom	3A
Current Rating	3A
Temperaturbereich	-55°C ... +125°C
Temperature Range	-55°C ... +125°C
Verarbeitung	Reflow-Lötverfahren; weitere Informationen in Kapitel T
Processing	Reflow-soldering, detailed information in ch. T



© W+P PRODUCTS

Passende Buchsenleisten Serie:
Mates with Female Headers Series:
3490 / 3491 / 1531 / 1532



Series*	Dimensions*	Contacts*	Plating*	Layout*	Packing*
3532	13	010	00	1	PPTR
Thermisch gerissene Kontakte Electro-strictioned contacts 3532 Einreihig Single row 3132 Zweireihig Double row	12 A=9,40; B=5,30mm 13 A=10,70; B=6,60mm 14 A=12,00; B=7,90mm 15 A=12,90; B=8,80mm 16 A=15,80; B=11,70mm 17 A=17,90; B=13,80mm 18 A=19,70; B=15,60mm 19 A=20,90; B=16,80mm 20 A=23,00; B=18,90mm	003-050 Einreihig Single row 004-100 Zweireihig Double row	00 Vergoldet Gold plated 10 0,25µm Gold 0,25µm gold plated 50 Verzinkt Tin plated	0 Zweireihig (3132) Double row (3132) 1 Layout B1 (3532) Layout B1 (3532) 2 Layout B2 (3532) Layout B2 (3532)	00 ST PPST PPTR

Weitere Stiftlängen und Veredelungen auf Anfrage.
More pin length and plating options by request.

(* Bestellbeispiel - Bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* Order example - To be replaced by your specifications.)

Lieferformen / Packing Options:

00 = Schüttgut ohne PP-Pad / Bulk good w/o PP-Pad
ST = In Stangen ohne PP-Pad / In tubes w/o PP-Pad
PPST = In Stangen mit PP-Pad / In tubes with PP-Pad
PPTR = Tape & Reel mit PP-Pad / Tape & Reel packing with PP-Pad

TEL.: +49 5223 98507-0
FAX.: +49 5223 98507-50

W+P PRODUCTS

E-MAIL: sales@wpro.com
INTERNET: www.wpro.com

Informationen zum Reflow-Lötverfahren

Reflow-Soldering Information

Reflow-Lötverfahren Reflow-Soldering

Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflowverfahren verarbeitet werden (Maximalwerte)

Profil Eigenschaft	Bleifreies Löten
Durchschnitts-Ramp-Up Rate ($T_{S_{max}}$ to T_p)	3°C / Sek. Max.
Vorheizen - Temperatur Min ($T_{S_{min}}$) - Temperatur Max ($T_{S_{max}}$) - Zeit ($t_{S_{min}}$ auf $t_{S_{max}}$)	150°C 200°C 60-180 Sekunden
Verbleiben oberhalb: - Temperatur (T_L) - Zeit (t_L)	217°C 60-180 Sekunden
Peak/Klassifizierung Temperatur (T_p)	260°C +/- 5°C
Zeit innerhalb von 5°C um die Peak-Temperatur (t_p)	20-40 Sekunden
Ramp-Down Rate	6°C / Sekunde max.
Zeit von 25°C bis zur Peak-Temperatur	8 Minuten max.

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature-profile for leadfree reflow-soldering (maximum values):

Profile Feature	PB-Free assembly
Average Ramp-Up Rate ($T_{S_{max}}$ to T_p)	3°C / second max.
Preheat - Temperature Min ($T_{S_{min}}$) - Temperature Max ($T_{S_{max}}$) - Time ($t_{S_{min}}$ auf $t_{S_{max}}$)	150°C 200°C 60-180 seconds
Time maintained above: - Temperature (T_L) - Time (t_L)	217°C 60-180 seconds
Peak/Classification Temperature (T_p)	260°C +/- 5°C
Time within 5°C of actual Peak-Temperature (t_p)	20-40 seconds
Ramp-Down Rate	6°C / second max.
Time 25°C to Peak Temperature	8 minutes max.

Empfohlenes Reflow-Lötprofil:

Recommended Reflow-Soldering profile:

